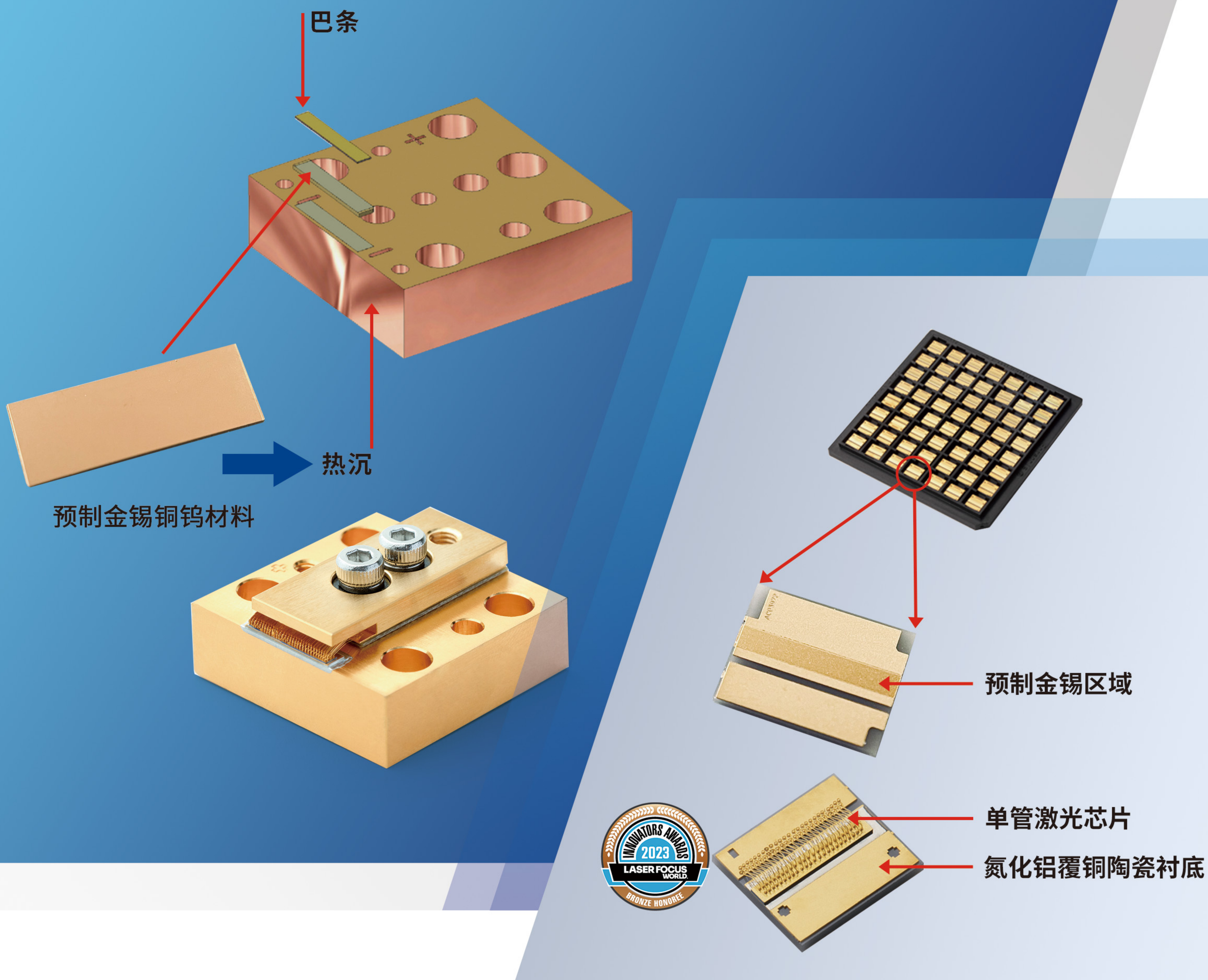


# 先进材料



## 产品特点

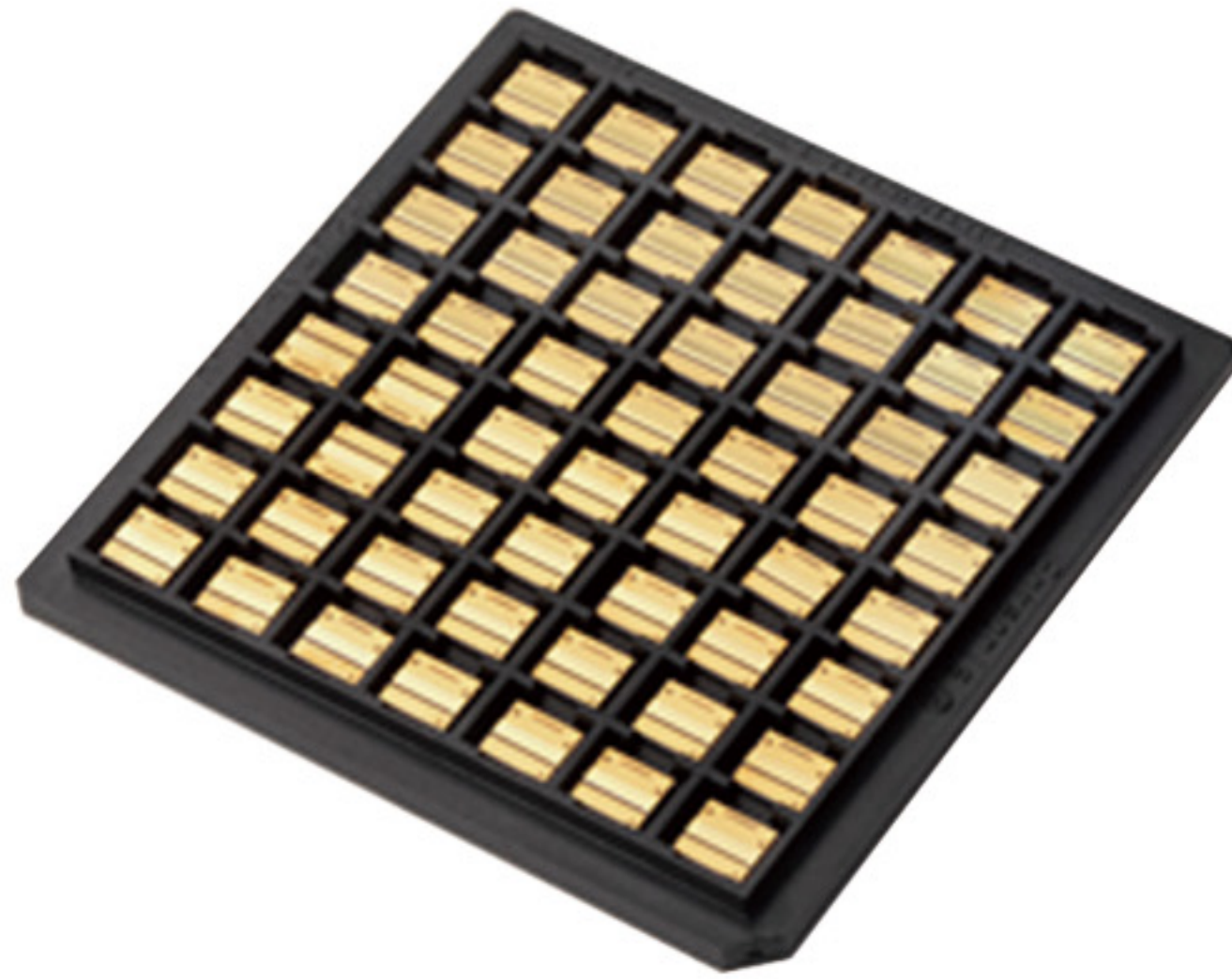
- 低热阻效应
- 高CTE匹配设计
- 高精度加工表面
- 高精度晶圆级工艺
- 高热导率基材
- 低弯曲度效应

## 典型应用

- 半导体激光芯片封装
- LED芯片封装
- 光通讯芯片封装
- IGBT器件封装
- 其他金属化需求

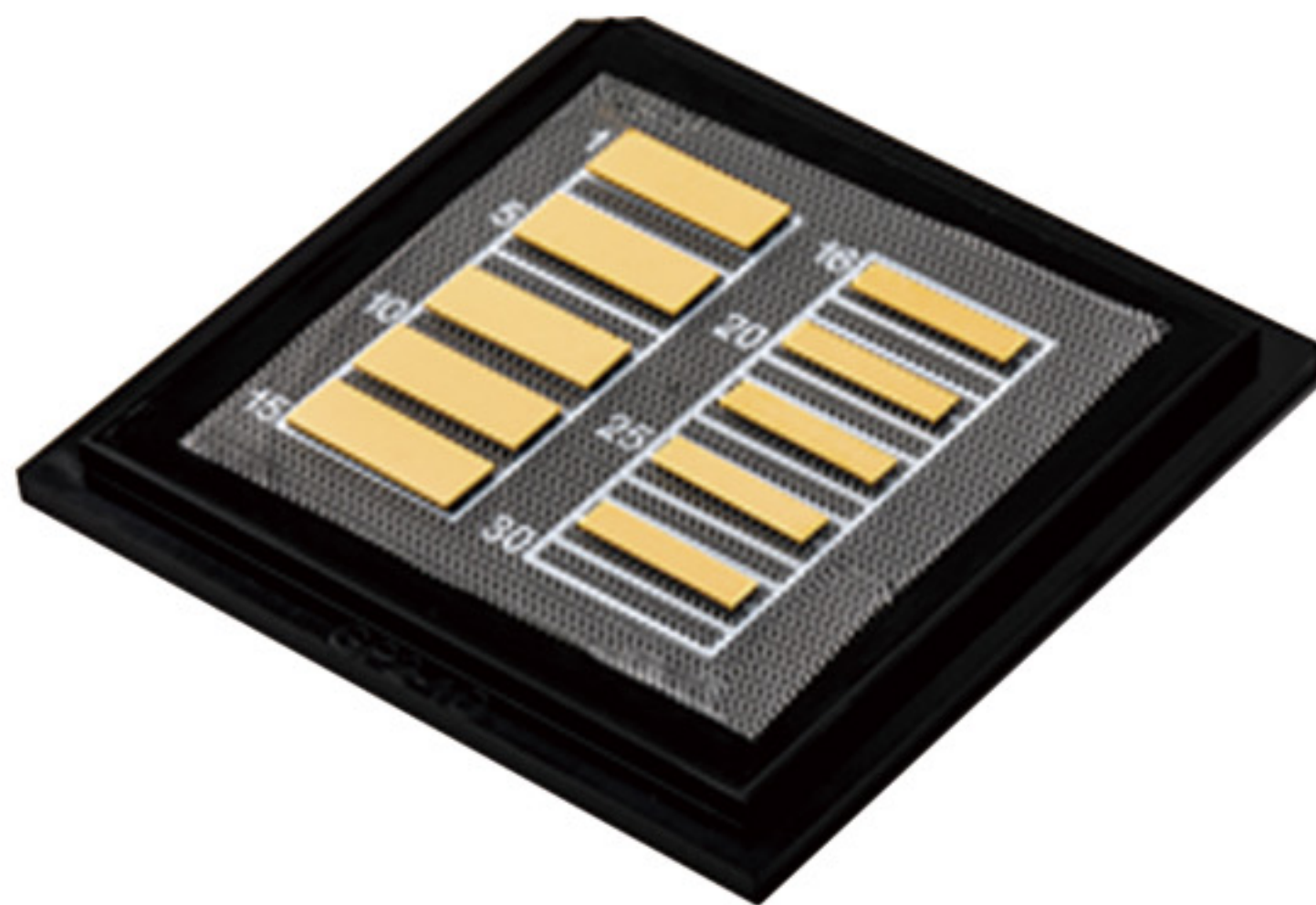


## AMC预制金锡氮化铝衬底



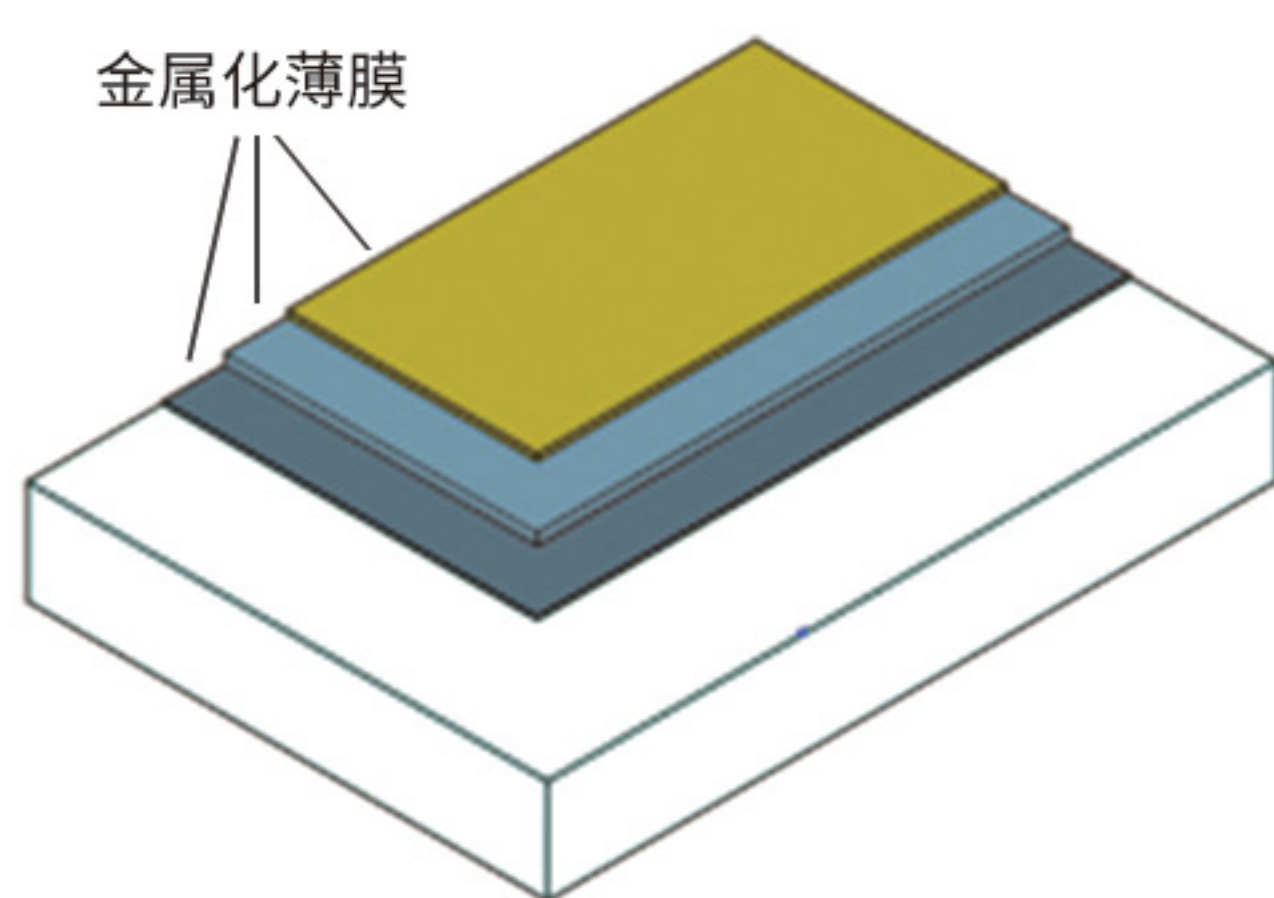
指标	FL-AMC-4045	FL-AMC-4048	FL-AMC-4557	
基板材质	氮化铝			
尺寸信息	长度(mm)	4.50	4.80	5.75
	宽度(mm)	4.00	4.05	4.50
	厚度(mm)	0.50	0.50	0.50
	金层厚度(μm)	≥1.0	≥1.0	≥1.0
	铜层Pullback (μm)	0~30	0~30	0~30
金锡参数	预制金锡厚度 (μm)	6.0+/-1.0	6.0+/-1.0	6.0+/-1.0
	熔点(°C)	280~320	280~320	280~320
关键表面参数	粗糙度(μm)	≤0.4	≤0.4	≤0.4
	平面度(μm)	≤2.0	≤2.0	≤2.0
热学参数	热阻(K/W)	≤2.1	≤2.1	≤2.1

## AMM预制金锡铜钨衬底



指标	AMM-10217506	AMM-10622503	AMM-11541003	
基板材质	钨 (10%) 铜 (90%)			
尺寸信息	长度(mm)	10.2	10.6	11.5
	宽度(mm)	1.75	2.25	4.10
	厚度(mm)	0.6	0.3	0.3
	金层厚度(μm)	≥0.25	≥0.25	≥0.25
金锡参数	预制金锡厚度(μm)	6.0+/-1.0	6.0+/-1.0	6.0+/-1.0
	熔点(°C)	280~320	280~320	280~320
	镀膜面	双面	单面	单面
关键表面参数	粗糙度(μm)	≤0.4	≤0.4	≤0.4
	平面度(μm)	≤10.0	≤10.0	≤10.0

## AMS金属化制造服务



金属化	工艺	厚度 (μm)	表面粗糙度(um)	平面度 (um)
预制金锡	PVD	1~7, +/-1	< 0.4	< 2
镀金	PVD	>0.15		
	电镀	>1		
镀镍	电镀	>1		
镀钛	PVD	>0.05		
镀铂	PVD	>0.05		

## 公司简介

炬光科技为国家级高新技术企业，上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688167），成立于2007年9月，主要从事光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料，激光光学元器件，光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统的研发、生产和销售，重点布局光通信、汽车应用、泛半导体制程、医疗健康。炬光科技已发展成为全球高功率半导体激光器及应用领域有影响力的公司和品牌，目前在中国西安、东莞、海宁、韶关，德国多特蒙德，瑞士纳沙泰尔，新加坡拥有生产基地和核心技术团队。公司于2017年成功收购LIMO GmbH，2024年成功收购SUSS MicroOptics SA（现Focuslight Switzerland SA），同年成功收购ams OSRAM资产并拓展Heptagon品牌下的全球光子行业工艺和制造业务。